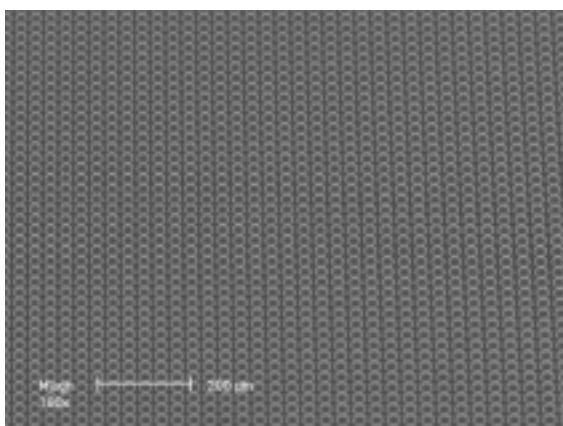


添付資料 ご参考写真

[写真1] 検出信号処理用CMOSデバイス上に形成した $35\mu\text{m}$ ピッチの鉛フリー・ bumps

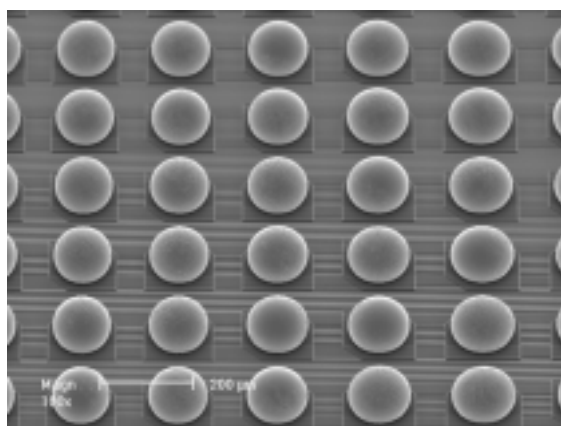
[写真2] 検出信号処理用CMOSデバイスとX線検出用デバイスとを、高精度フリップチップ
接続技術を用いて実装したChip-on-Chipの接合部断面

[写真3] 本技術を採用したVATECH社製医療用X線イメージセンサーの外観



0.200mm

[写真 1] $35\mu\text{m}$ ピッチ・ bumps



0.200mm

[ご参考] $220\mu\text{m}$ ピッチ・ bumps



0.200mm

[写真 2] $35\mu\text{m}$ ピッチ・ bumps実装



0.200mm

[ご参考] $220\mu\text{m}$ ピッチ・ bumps実装



[写真 3] 歯科用 X 線イメージセンサー (外
観)



[ご参考] Chip-on-Chip MCM
(X 線検出用デバイス [上部] と、検出信号
処理用 CMOS デバイス [下部に 4 ケ])